2208102
2002051175

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

162162

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2002 年7 月18 日 (18.07.2002)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 02/056352 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP01/07789

(22) 国際出願日: 2001 年9 月7 日 (07.09.2001)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2001-6203 2001 年1 月15 日 (15.01.2001) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山口弘一 (YAMAGUCHI, Koichi) [JP/JP]; 〒173-0001 東京都板橋区本町23-23 リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄(YAMAGUCHI, Yoshio); 〒206-0034 東京都多摩市鶴牧1丁目4番17号 いずみビル6F Tokyo (JP).

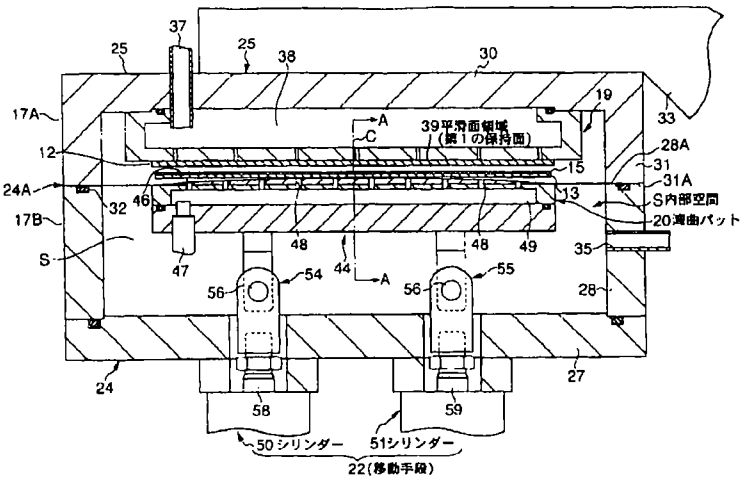
(81) 指定国 (国内): DE, GB, JP, PH, SG, US.

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: BONDING APPARATUS, AND BONDING METHOD

(54) 発明の名称: 貼合装置及び貼合方法



39...FLAT FACE REGION (FIRST HOLDING FACE
S...INTERNAL SPACE
20...CURVED PAD
50...CYLINDER
51...CYLINDER
22...MOVING MEANS

(57) Abstract: A bonding apparatus (10) comprises a vacuum grid (19) for holding a glass substrate (12), a curved pad (20) opposed to the glass substrate (12) and used for holding an bond member (16) composed of a wafer (13) and an adhesive tape (15), and moving means (22) for bringing the curved pad (20) toward the vacuum grid (19). The curved pat (20) has a curved face region (46) the distance of which from a flat face region (39) of the vacuum grid (19) is gradually increased outward from a central portion (C). As the vacuum grid (19) and the curved pad (20) are brought close to each other in a substantially vacuum chamber by the moving means (22), the glass substrate (12) and the bond member (16) are gradually bonded to each other while releasing a small quantity of air, if any inbetween, to the outside.

[続葉有]

WO 02/056352 A1

ACTION